

Micro Systems Engineering GmbH (MSE) ist seit über 25 Jahren in Berg/Oberfranken in unmittelbarer Nähe von Hof beheimatet.

Ursprünglich gegründet als Hersteller von Elektronikmodulen für aktive medizinische Implantate (Herzschrittmacher) sind wir heute ein führendes Unternehmen sowohl für anspruchsvolle Aufbau- und Verbindungstechnik, als auch für keramische Mehrlagen-Substrate (LTCC). In diesem Bereich sind wir europäischer Marktführer und gelten weltweit als einer der kompetentesten Ansprechpartner überhaupt.

Zur Verstärkung unseres mittlerweile auf 200 Mitarbeiter angewachsenen Teams, speziell für die Entwicklung und Betreuung neuer Produkte und technologischer Verfahren, suchen wir

Prozessingenieur Packaging w/m

- Ausbildung:**
- Dipl.-Ing., B.Eng., M.Eng. Feinwerktechnik
 - Elektrotechnik/Elektronik, Werkstoffkunde
 - Kunststofftechnik, Physiker, Chemiker
- Berufserfahrung:**
- Halbleiterproduktion Backend oder Aufbau- und Verbindungstechnik in der Baugruppenfertigung
 - Schwerpunkte Transfermolden, Drahtbonden, Diebonden
 - Mehrjährige Berufserfahrung in Produktion und/oder Prozessentwicklung
- Fachliche Anforderungen:**
- Detaillierte Kenntnisse der elektronischen Aufbau- und Verbindungstechnik
 - Erfahrung als Projektleiter oder -mitarbeiter in standortübergreifenden Projekten
 - Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kontaktieren Sie uns bitte.

Frau Christine Priedöhl
Micro Systems Engineering GmbH
Schlegelweg 17
D-95180 Berg, Germany
christine.priedoehl@mse-microelectronics.de
Tel. +49 (9293) 78-0